

**LemTech**

Lemtech Holdings Co., Limited

# 聯德控股股份有限公司

## 2014年度財務表現

報告人 盧晉佑經理



# 內 容

- 關於聯德
- 營業項目
  - 模具設計研發能力
  - 智慧型手機零件
  - 汽車零件
  - 3C產品的散熱解決方案
  - 伺服器散熱之新技術
  - 企業伺服器導軌
- 聯德的客戶群
- 財務表現

- 提供的產品包含：  
*精密模具, 金屬沖壓,  
專業客製化的散熱模組, 鉸鏈/滑軌  
給消費型電子產品, 伺服器產品,  
車用產品, 建築產品等等*
- 在全球四個國家設有營運據點及工廠
- 2011年正式在櫃檯買賣中心掛牌交易
- 2014年集團營額突破1億美元
- 獲得ISO9001:2000, ISO/TS16949, ISO14001:2004的認證





- **TAIWAN**
- ★ Taipei (HQ)



**China**



• **Thailand**



★ **Taiwan**

- **CHINA**
- KunShan
- Hong Kong

- **THAILAND**
- Ayutthaya

- **USA**
- San Jose, CA

- **5 Manufacturing Sites/Offices**
- ~ Total Floor Space: 500,000 sqft
- ~ Total Headcount 1,200

**LemTech**

Lemtech Holdings Co., Limited

# 營業項目

**LemTech**

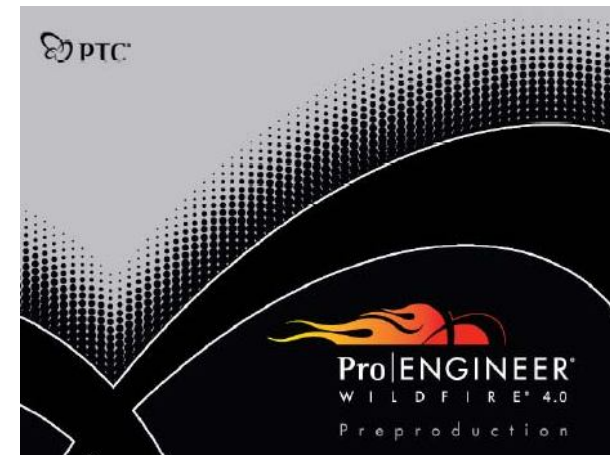
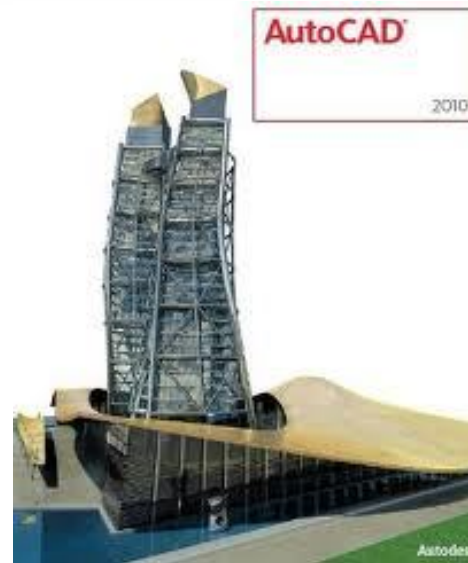
Lemtech Holdings Co., Limited

# 模具設計製造能力

## Product Design Platforms

3D : Solidworks/pro-E

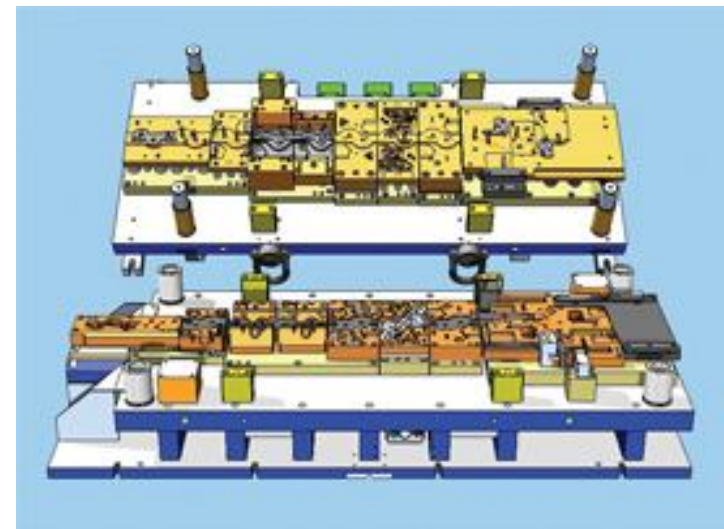
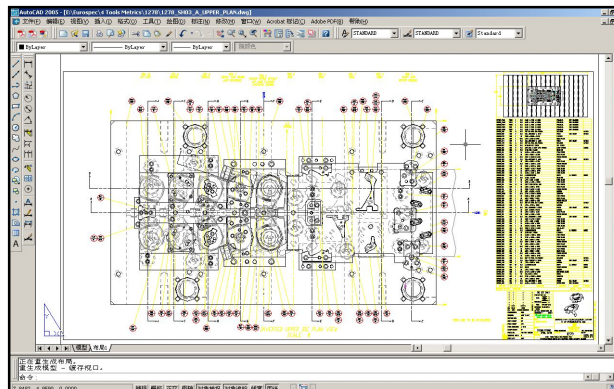
2D : AutoCad



## Tool Design Platforms

3D : Key creator

2D : PressCad



## Tool Room Equipment 模具加工母機



CNC Wire EDM Area



AgieCharmilles - Wire EDM



Surface Grinders



Horizontal CNC Machining Center



Vertical CNC Machining Center



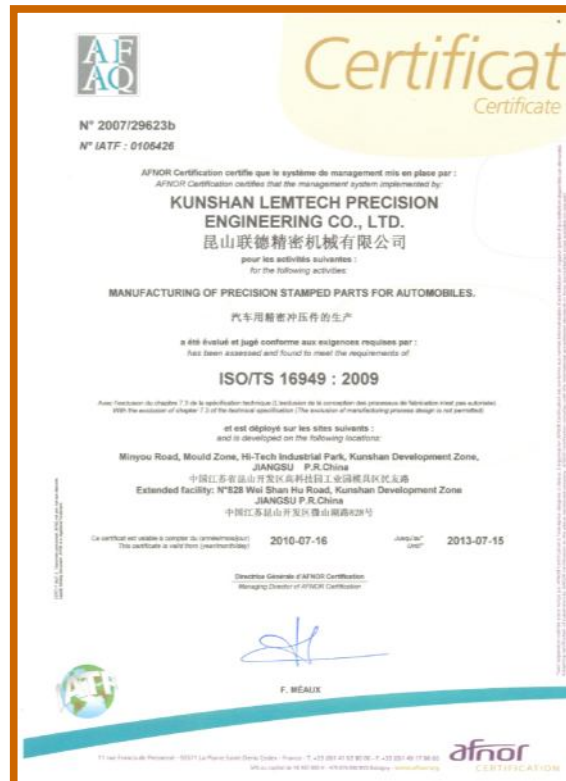
## 沖壓機台從 25 噸到800噸 (合計120 台)



## 後製程自動化



## 品質保證

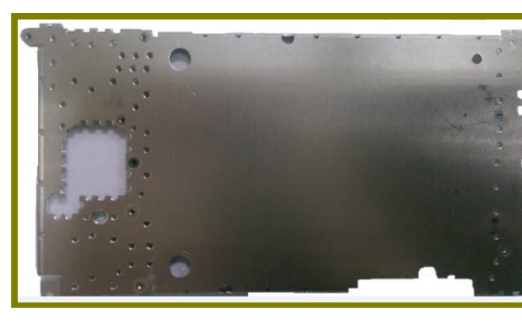
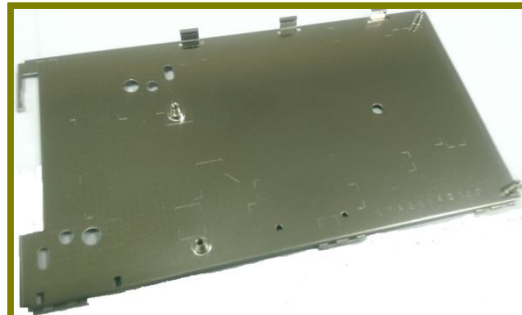
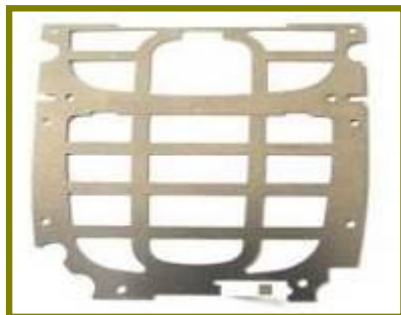


**LemTech**

Lemtech Holdings Co., Limited

# 智慧型手機零件

## 消費型電子產品零件



## 行動電話系列之電源/音量/耳機



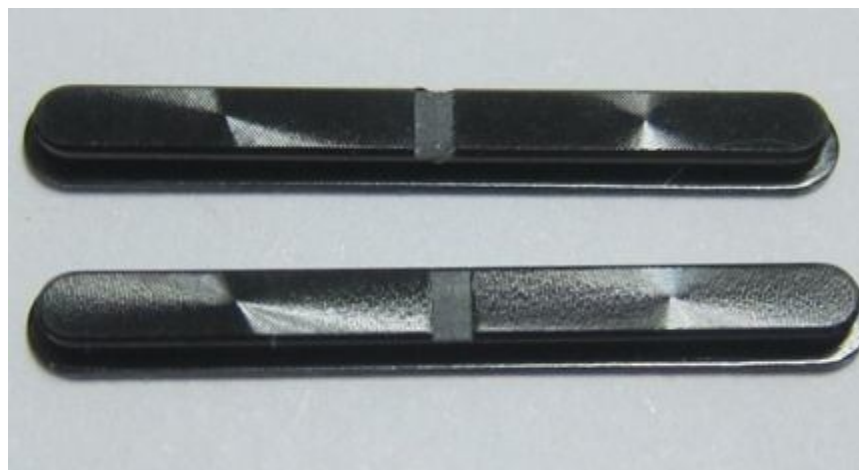
手機之耳機環



手機之音量鍵



手機之電源鍵



手機之音量鍵

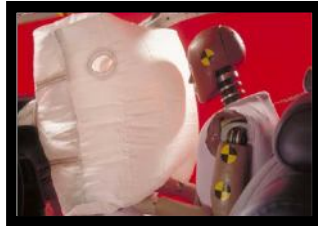
**LemTech**

Lemtech Holdings Co., Limited

# 汽車業務

## Parts For Various Automotive Applications

### 安全氣囊



### 安全帶系統



### 車門鉸鍊



### 天窗及音響設備



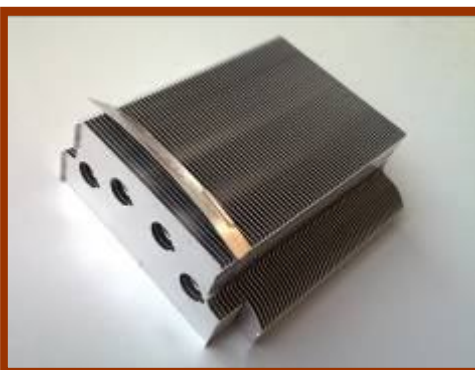
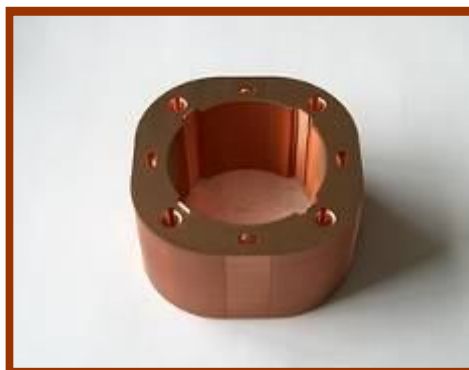


# 3C 產品之散熱解決方案

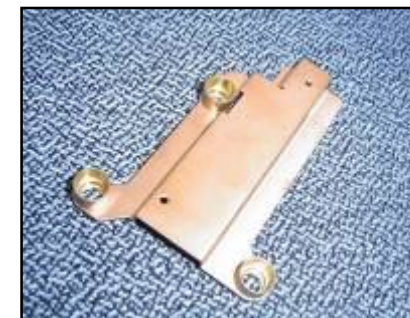
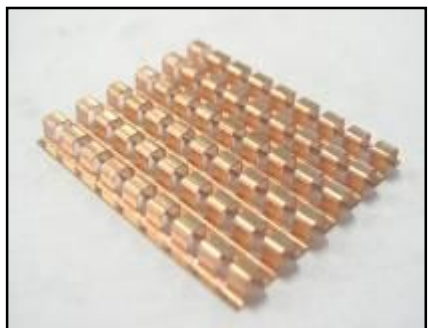
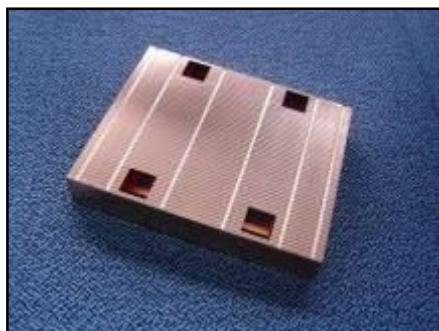
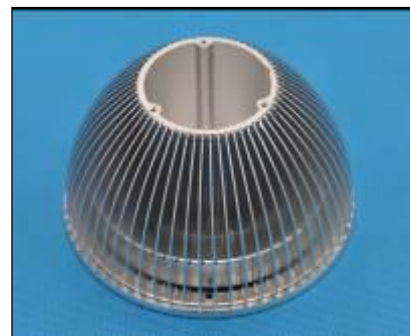
## 散熱模組組裝產線及測試設備



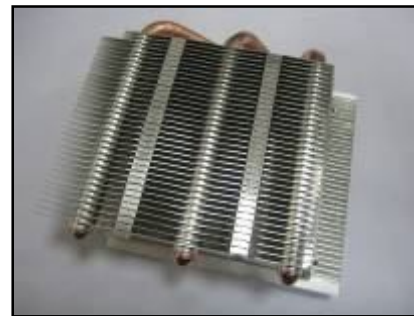
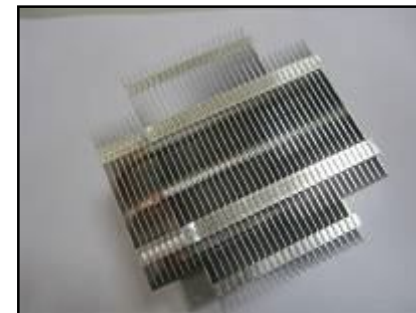
消費性電子散熱產品



## 3C電子之散熱產品



## 無焊接製程之散熱產品



# 雲端運算中心之散熱新技術

- 冷卻系統為雲端數據中心的關鍵系統，優良的冷卻系統可提供更低成本的建置與
- 營運成本，同時可提高能源利用效率

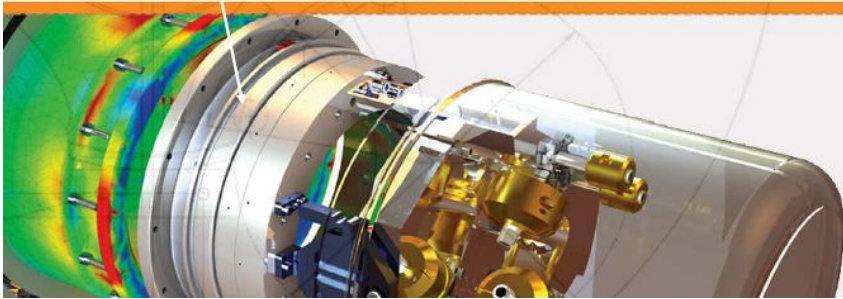


•Source: <http://www.google.com/about/datacenters/>

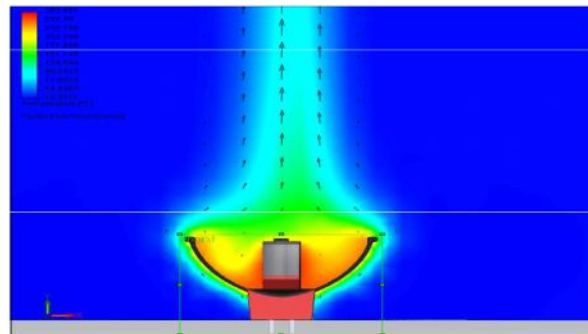
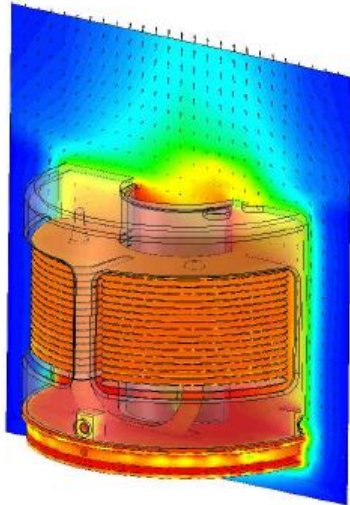
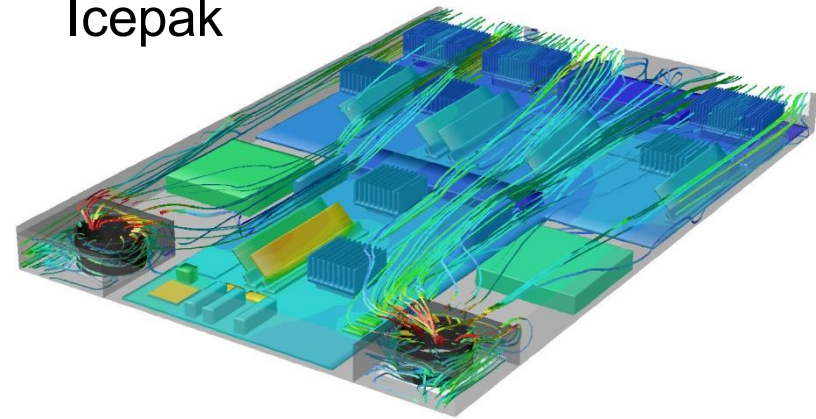
- 冷卻系統所需電能為總營運電能之40%，高效率的散熱技術可減少能源需求
- 雲端數據中心的營運成本與冷卻風流量成正比，好的散熱技術可降低風流需求量

## 散熱模流模擬軟體

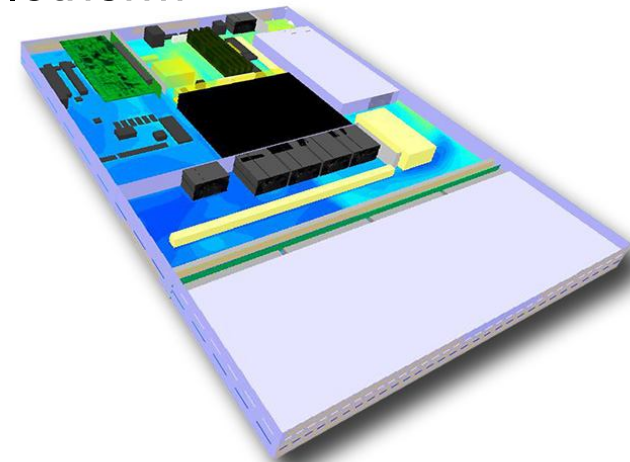
SolidWorks Flow Simulation



Icepak



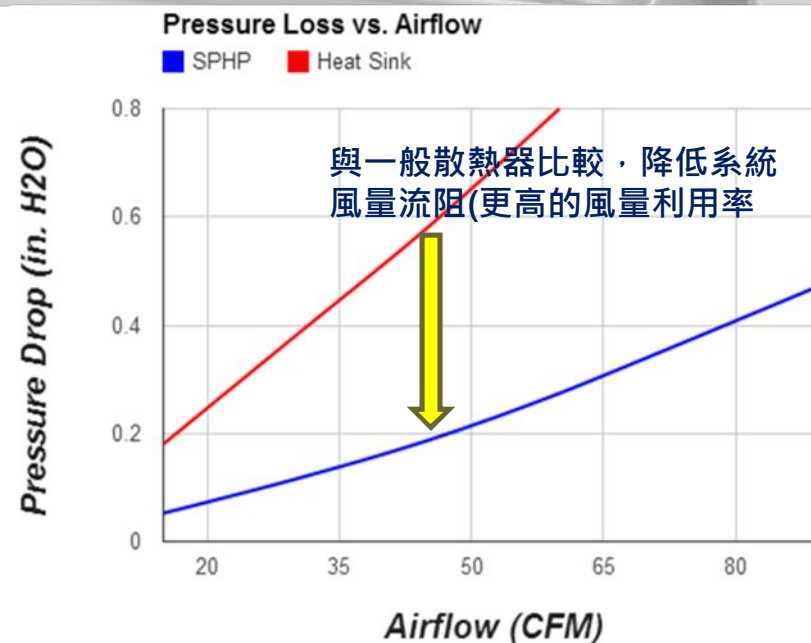
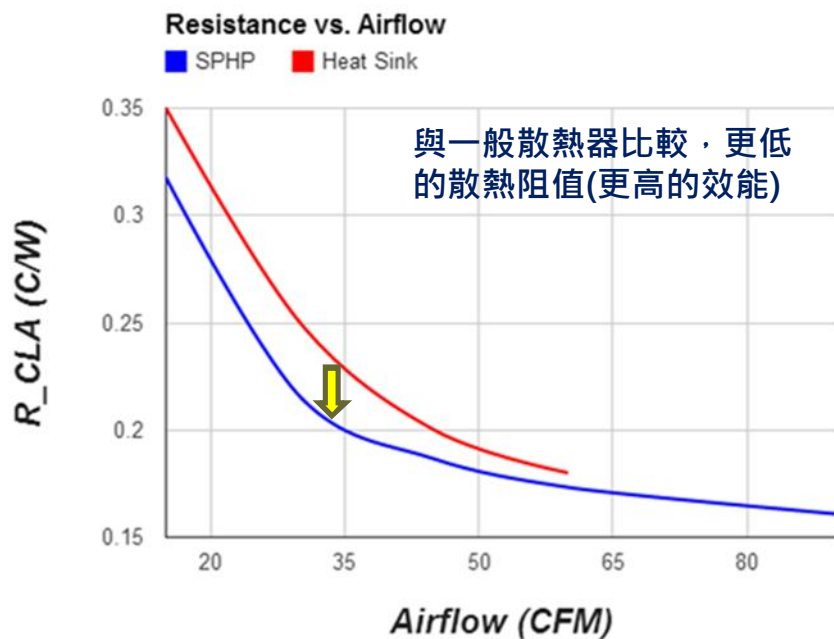
Flotherm





### ● 兼顧性能與成本之創新設計

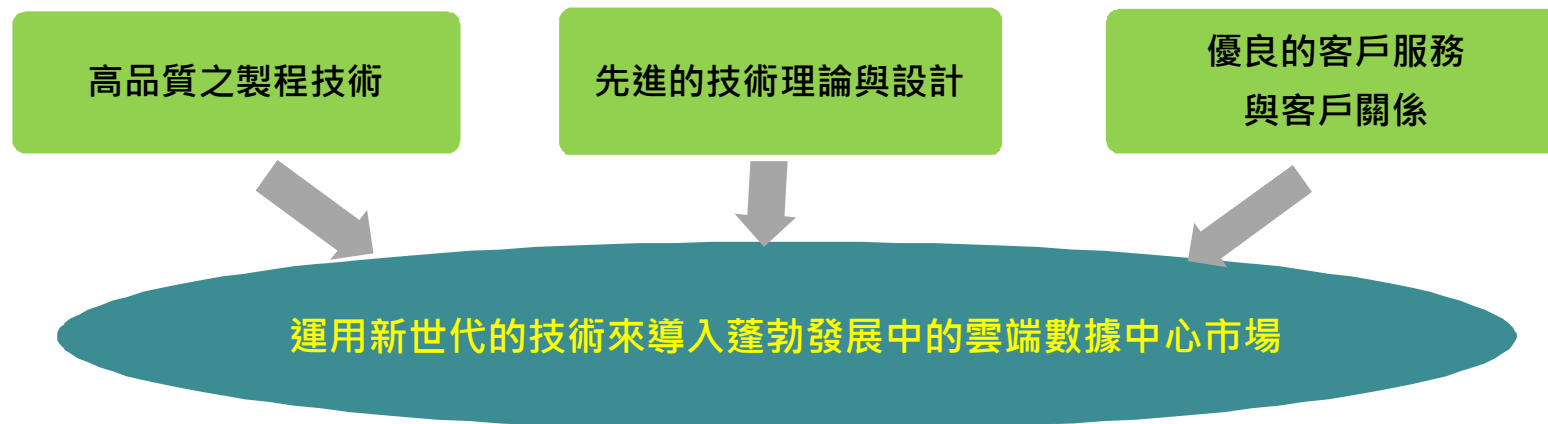
- 自主循環、液氣兩相流、遠端冷凝之設計
- 降低重力對性能的影響
- 解決多重熱源之共平面問題
- 熱源與冷凝器的位置可彈性配置
- 可相容更高瓦數的CPU
- 大幅提升機箱內風流量的利用效率



- **MarketsandMarkets研究報告**：未來四年內，全球的雲端數據中心散熱系統的市場需求將以**10.4%**的年增率成長
- **Intel 2013年財務報告**：112億美金的營收來自雲端數據中心，總共售出1900萬顆CPU，等同有1900萬個散熱模組需求
- **DCD Intelligence**：雲端數據中心的市場將會是每年成長**15%**
- 雲端數據中心的硬體採購金額將在2014年會超越1060億美金，預期在2015年達到1260億美金且其中100億美金將來自散熱系統

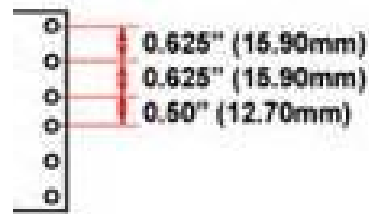
潛在客戶：HP, Amazon, IBM, Google, Dell, Facebook, Oracle, Cisco, Twitter, Rackspace, Lenovo, NEC, Huawei, Fujitsu, Hitachi

## 聯德之優勢



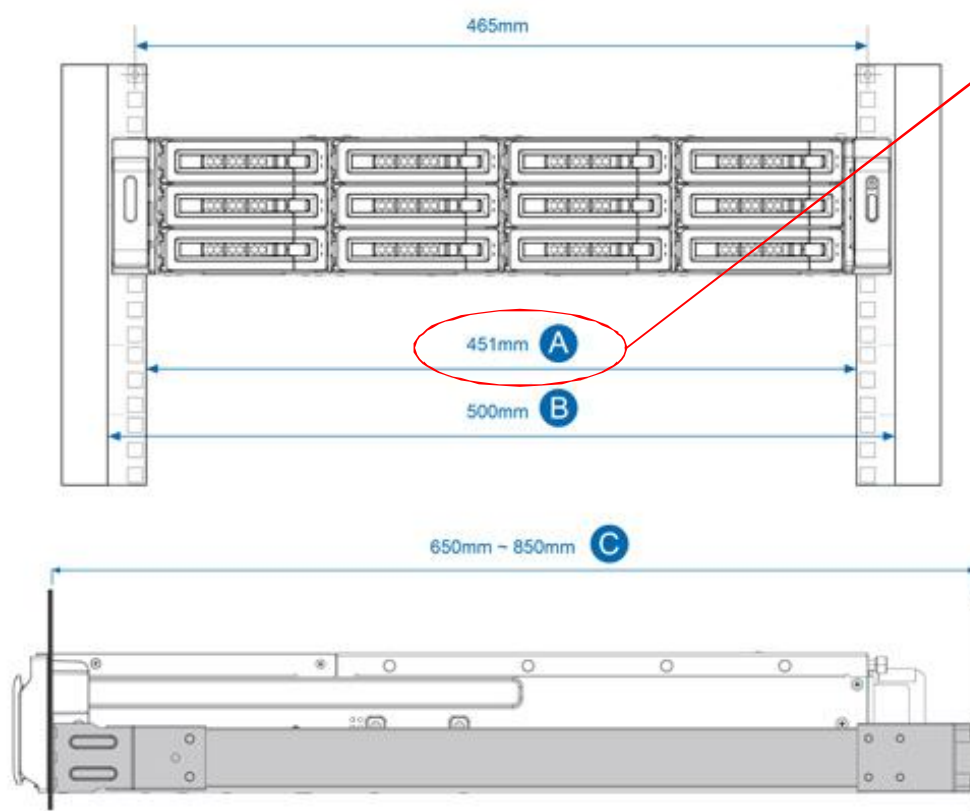
## 簡 介

- 適用業界標準19吋機架
- 滑軌長度：22" ~ 32"
- 承載 1U ~4U 伺服器
- 1 機架單位 (1U) = 1.75" = 44.45mm
- 承載率：2.5 倍最高系統重量

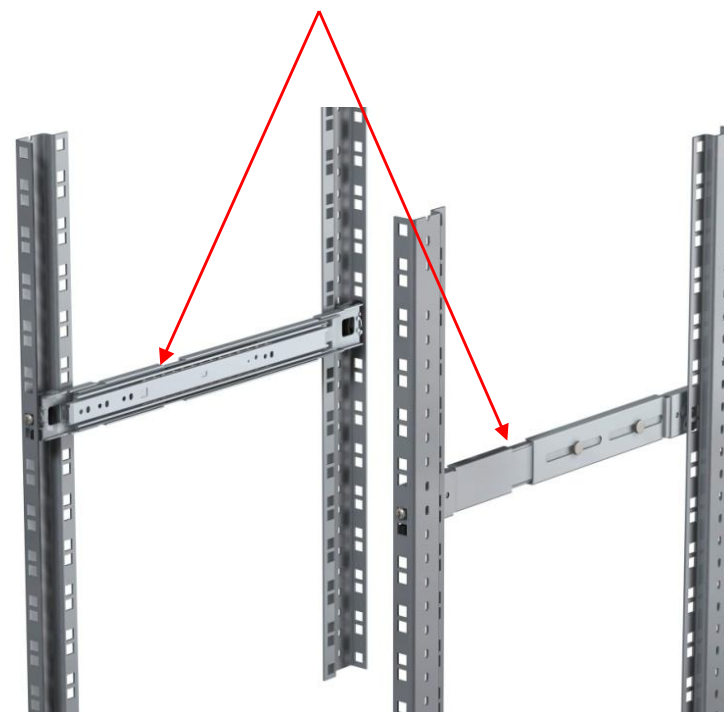


Wide angle view

## 業界標準 19 吋 機架



架臂兩端的寬度 (451mm) 為侷限所在. 滑軌的厚度形成決定伺服器機架的最大寬度.



## 徒手式組裝設計

- 毋需使用工具即可將滑軌嵌槽置入 EIA 框緣
- 簡易手動即可拆解彈簧鎖扣
- 可彈性調整長度符合各式機架深度

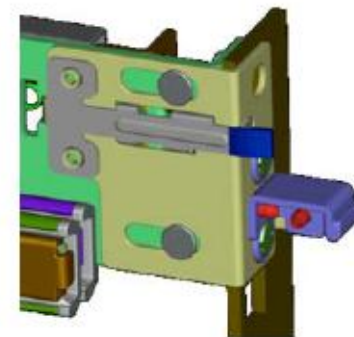
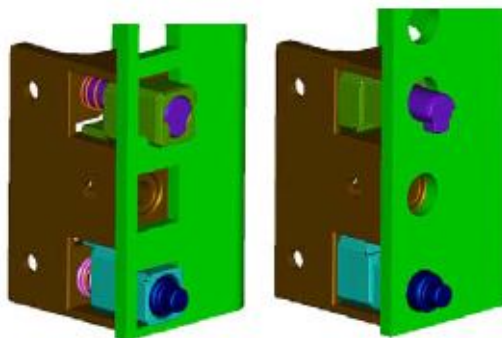
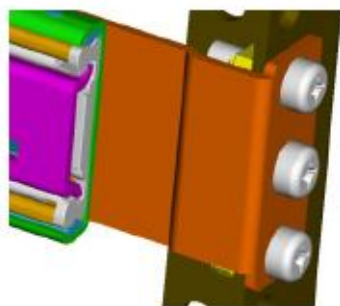
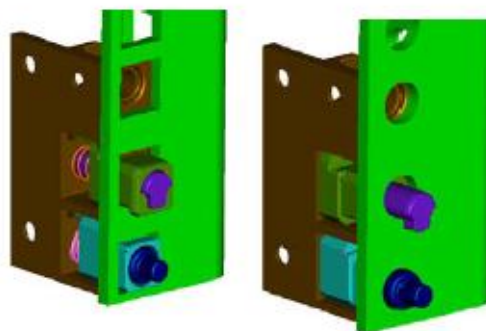
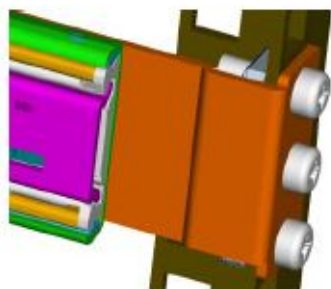


正面組立圖



背面組立圖

## 各式機架組配界面



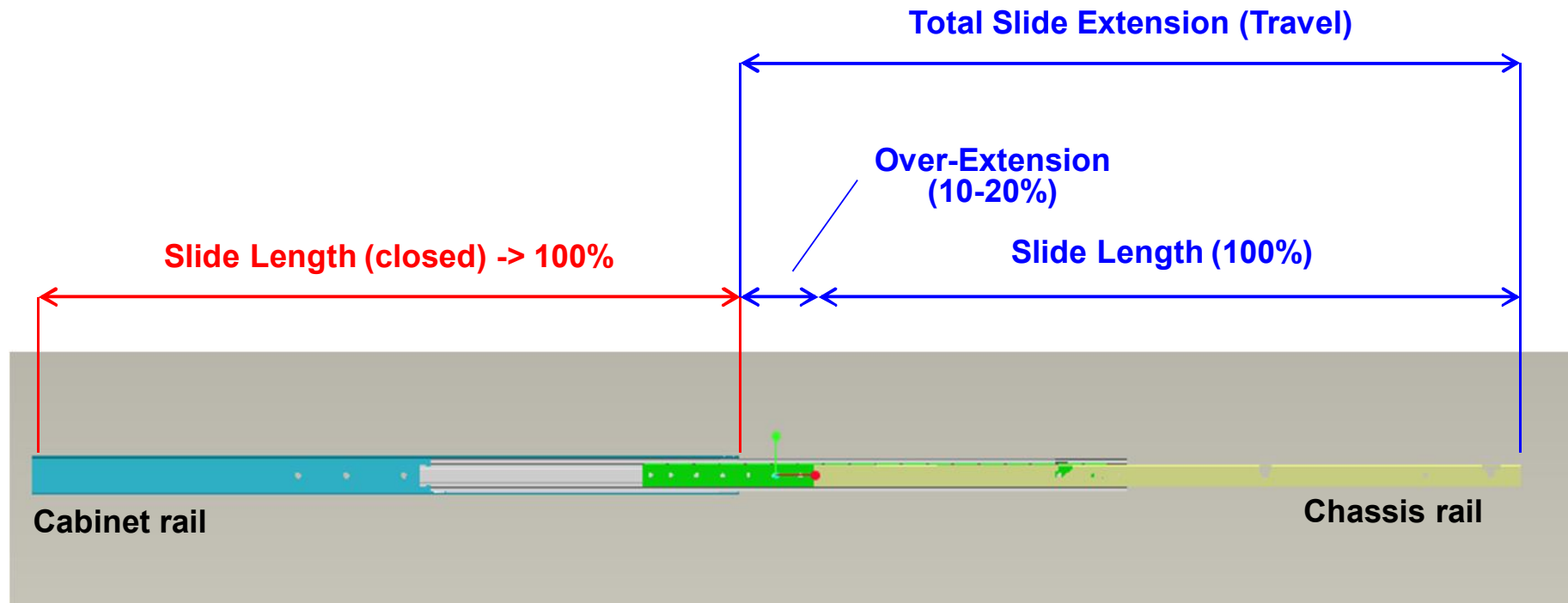
通用款  
(使用嵌钩方式)

徒手式安裝  
(利用三向設計, 適用圓形與方形接孔)

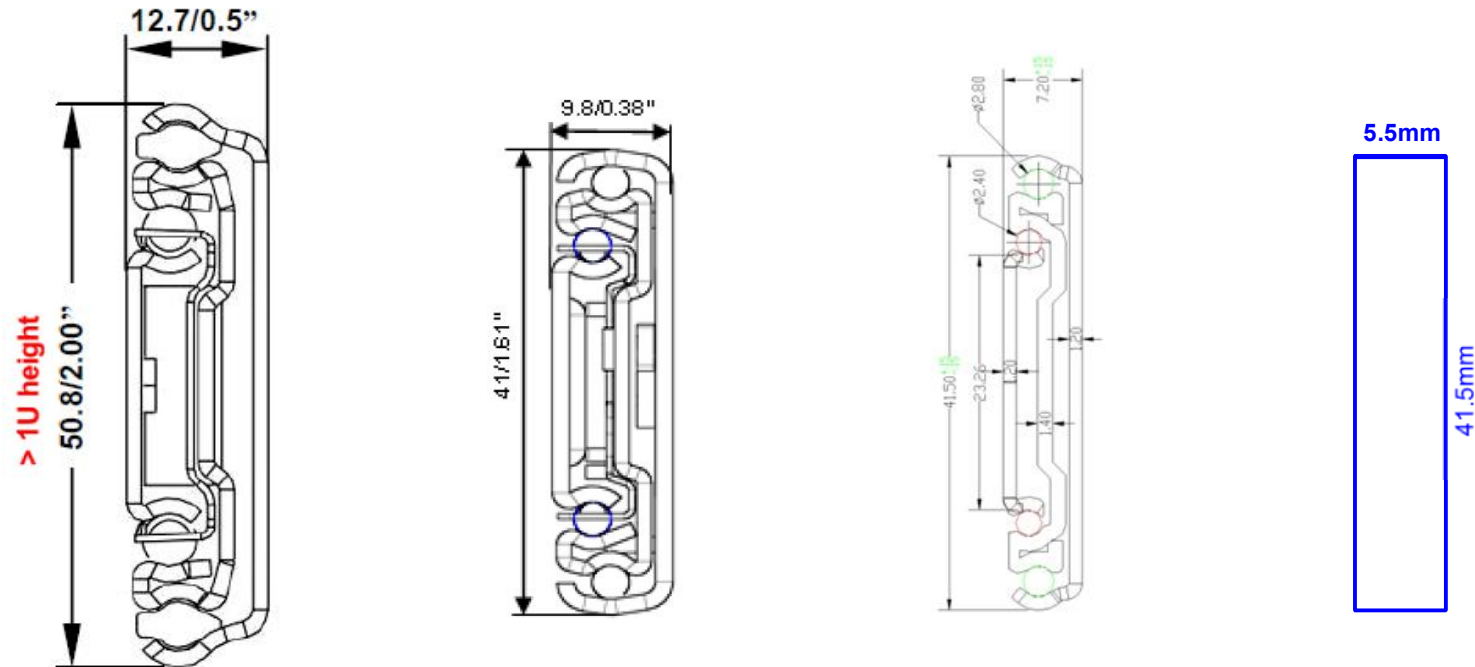
其它徒手式安裝

## 滑軌有效開合距離 (區間)

- 在完全展開的滑軌狀態下, 過度推展可使機箱與機架完全脫離, 便於檢視與維護設備



## 產品線開發方向 - 降低滑軌厚度, 同時還要維持現有滑軌的承載能力

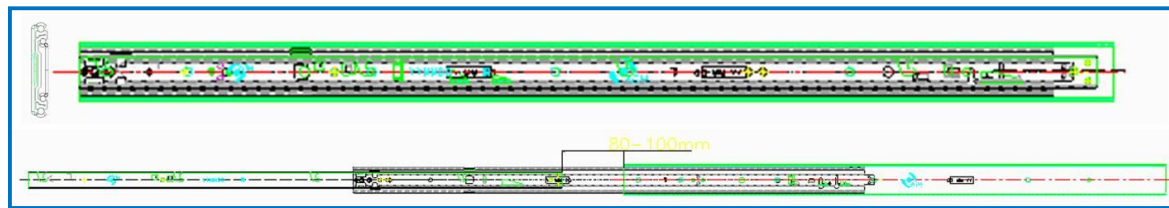


	< 2002	2002 to 2011	2012 to 2016	> 2016
Slide Thickness:	12.7mm	→ 24% → 9.6mm	→ 25% → 7.2mm	→ 24% → 5.5mm
Suitable For:	1.5U to 5U	1U to 4U	1U to 4U	1U to 2U
Max System Weight:	80kg	→ 25% → 60kg	→ 20% → 48kg	→ 21% → 38kg
Chassis Width:	< 434mm	< 434mm	434-436mm	< 440mm

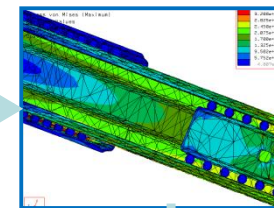


## 產品開發流程

•設計



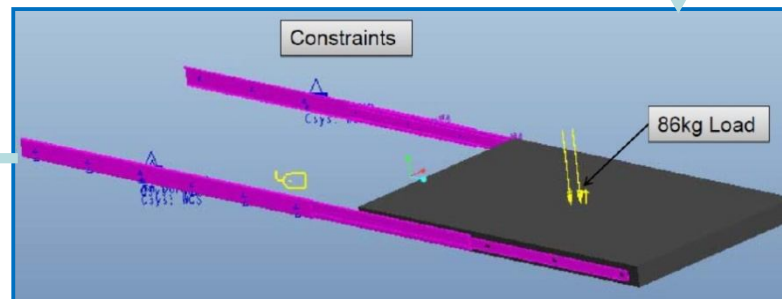
•模擬分析



•製作原型品



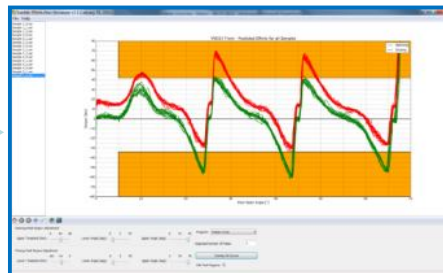
•驗證分析



•實體測試



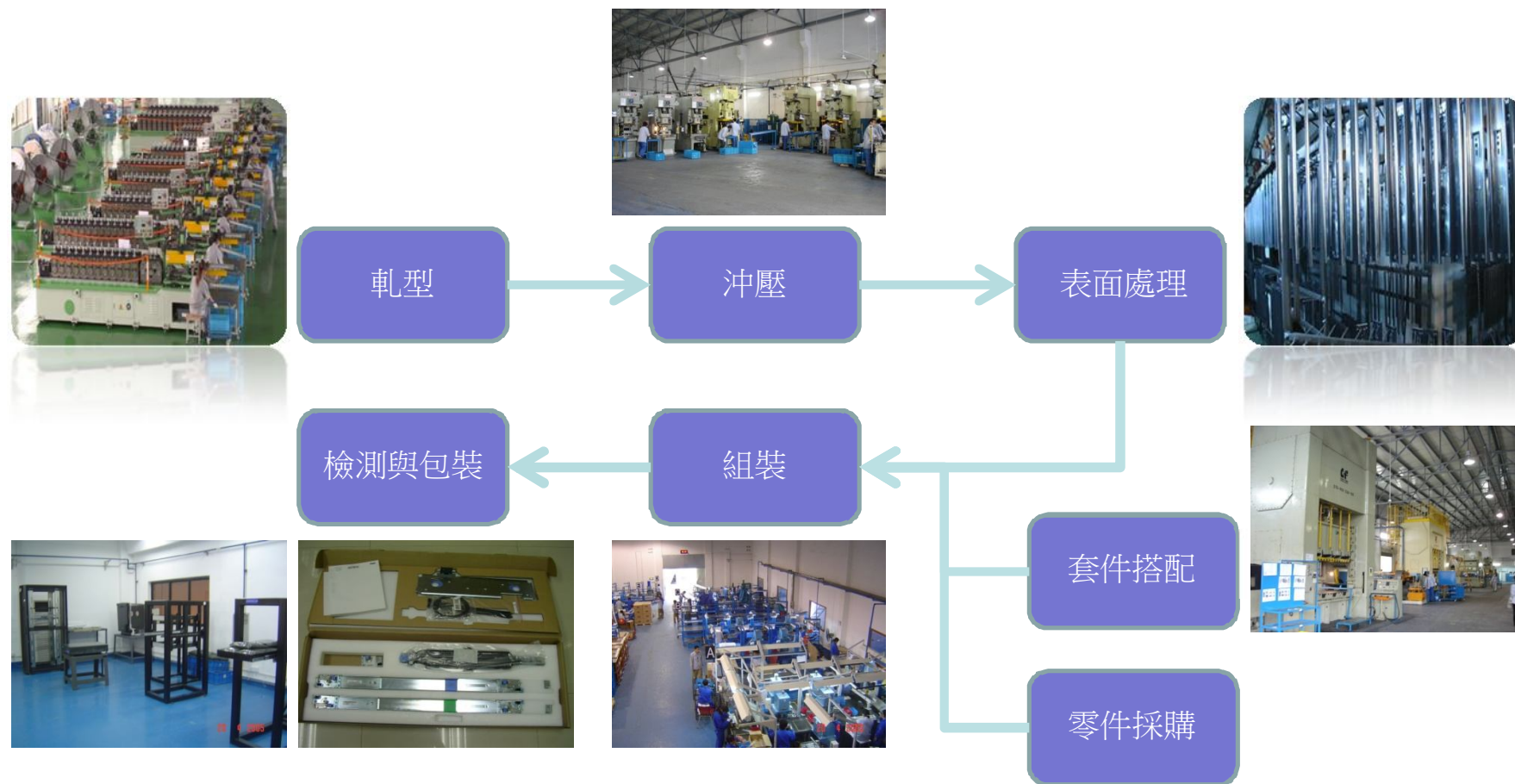
•資料蒐集匯整



•導入量產

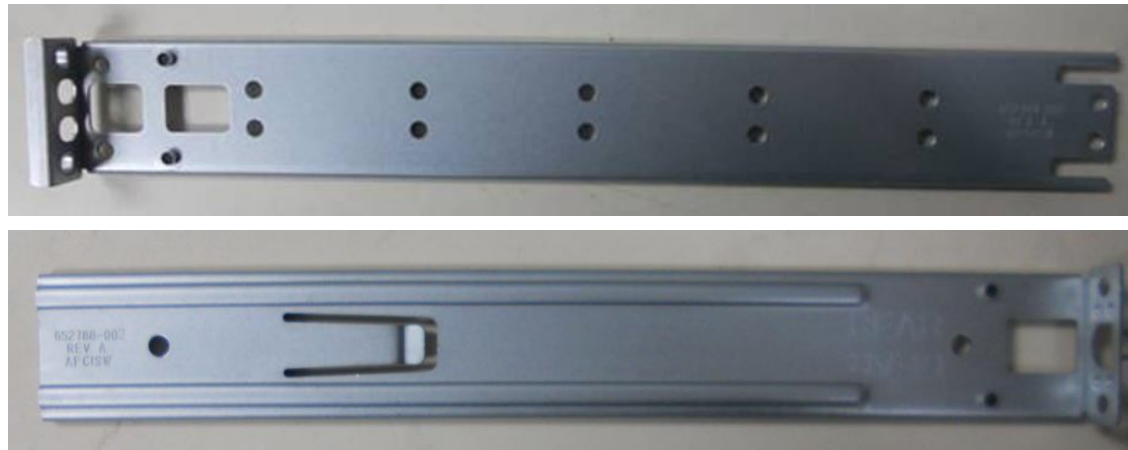


## 滑軌製造生產流程



## 聯德滑軌製造經驗與優勢

- 聯德具有10年以上的伺服器滑軌設計及製造經驗
- 聯德自2002年起替國際大廠如Accuride及CIS等代工生產滑軌產品與零件的製造經驗.
- 具備90%以上滑軌零組件自製的能力



## 聯德滑軌產品



接觸式滑軌  
(徒手式組裝)



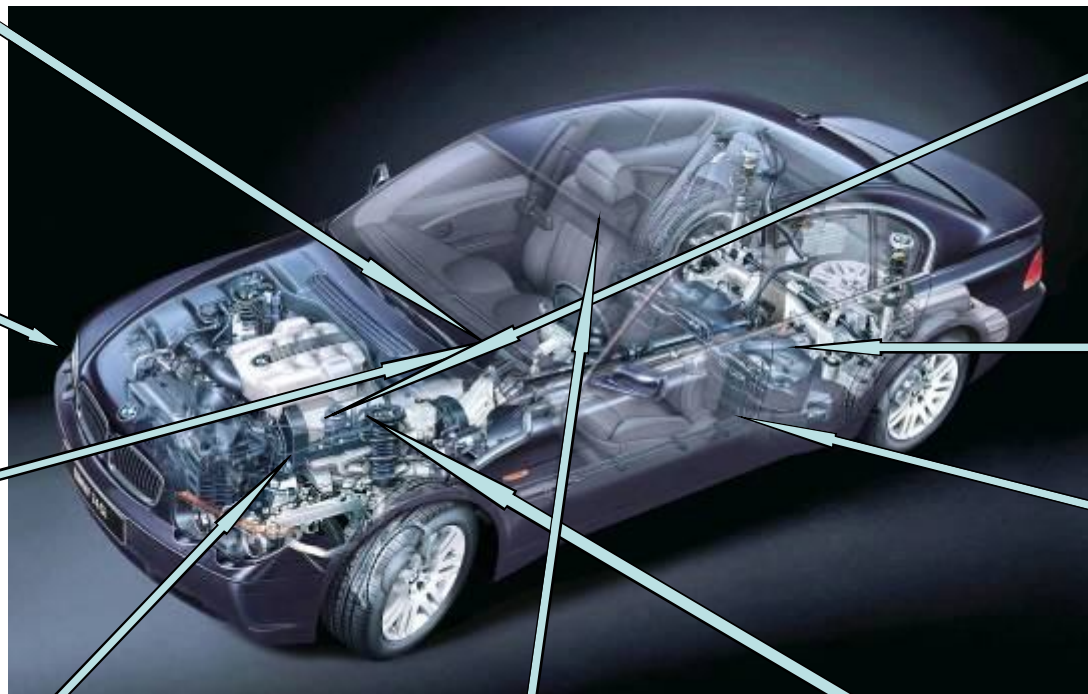
滾珠式滑軌  
(徒手式組裝)

**LemTech**

Lemtech Holdings Co., Limited

# 主要客戶群

## 汽車產品客戶



消費型電子產品客戶



**LemTech**

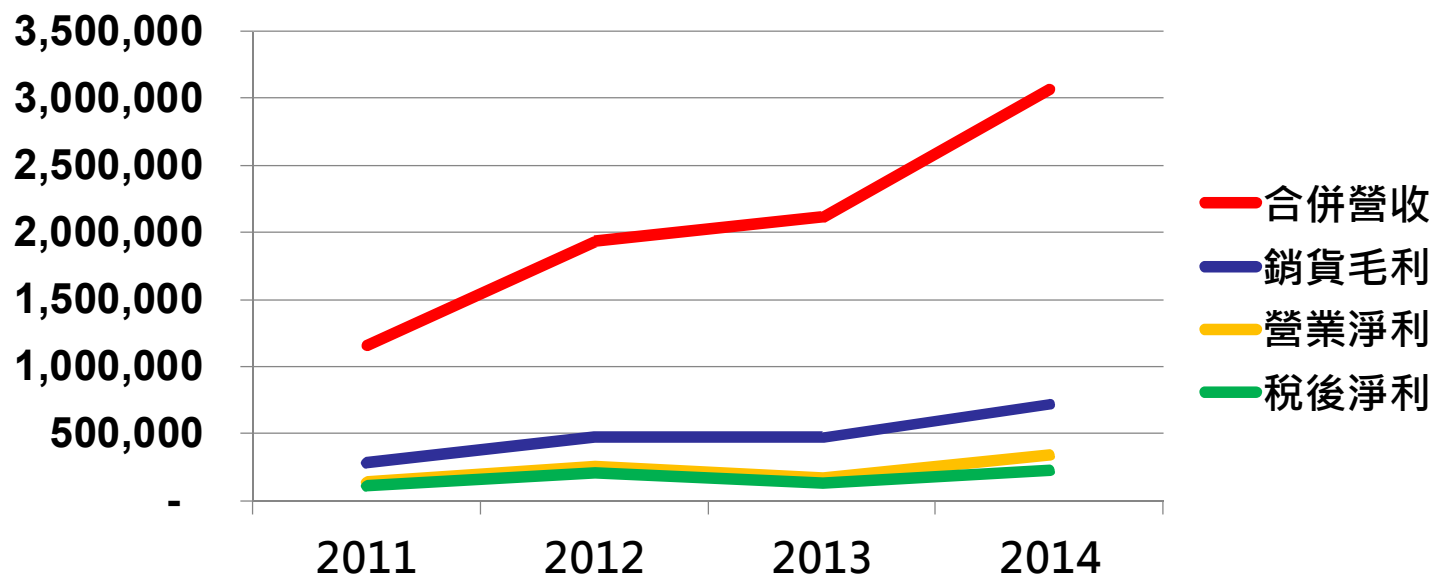
Lemtech Holdings Co., Limited

# 公司財務績效及狀況



單位：新台幣仟元

	2011年	2012年	2013年	2014年
合併營收	1,159,513	1,932,714	2,114,891	3,068,330
銷貨毛利	282,777	473,326	471,451	718,530
營業淨利	139,229	249,841	171,669	343,068
稅後淨利	107,667	204,396	131,234	221,406
每股盈餘	4.01	7.24	4.00	6.73



	2011	2012	2013	2014
流動資產	838,888	1,138,687	1,475,767	2,195,561
不動產、廠房及設備	273,974	361,709	569,940	604,325
其他資產	24,768	89,484	111,849	121,277
資產總額	1,137,630	1,589,880	2,157,556	2,921,163
流動負債	467,674	563,739	1,111,704	1,354,552
非流動負債	3,188	15,673	24,867	356,247
負債總額	470,862	579,412	1,136,571	1,710,799
權益總額	666,768	1,010,468	1,020,985	1,210,364

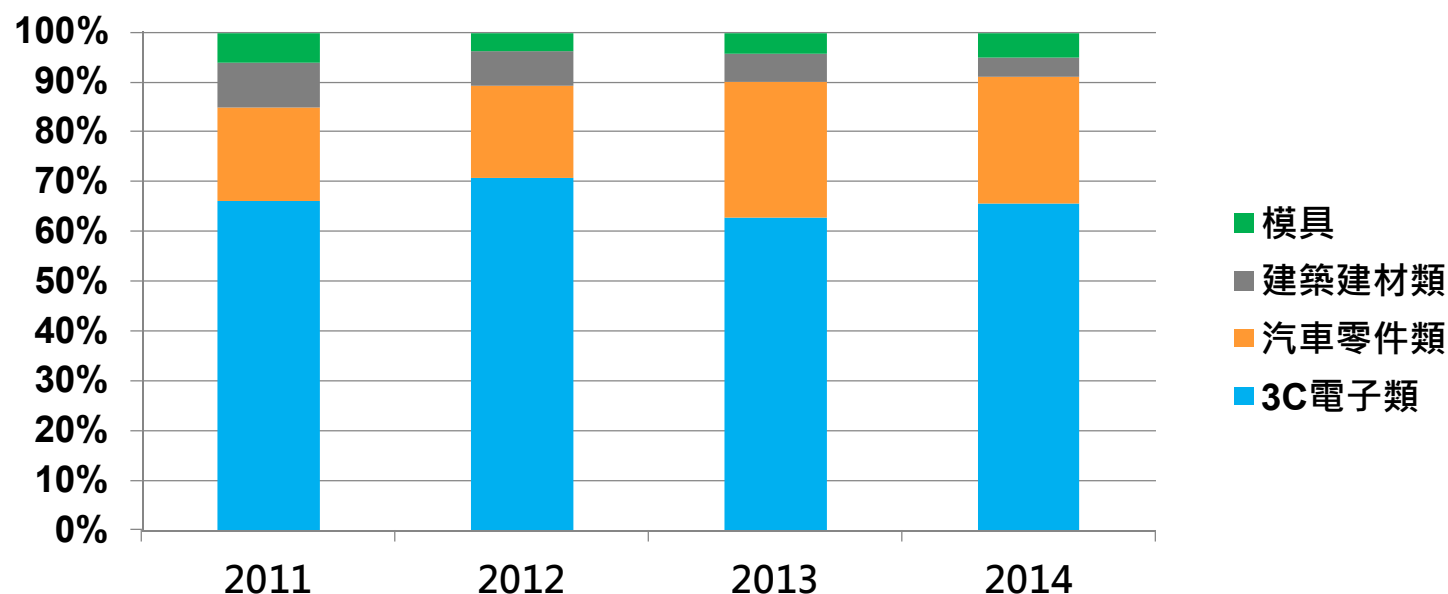
# 近四年財務比率表

		2011	2012	2013	2014
獲力能力	毛利率(%)	24.39	24.49	22.29	23.42
	費用率(%)	12.38	11.56	14.17	12.24
	營業利益率(%)	12.01	12.93	8.12	11.18
財務結構	負債比率(%)	41.39	36.44	52.68	58.57
	現金與約當現金(仟元)	192,243	430,727	378,673	358,990
償債能力	流動比率(%)	179.37	204.59	132.75	162.09
	速動比率(%)	142.59	173.05	111.53	140.21
經營績效	應收款項週轉天數	131	96	106	73
	存貨週轉天數	52	41	44	29
	應付款項週轉天數	127	93	129	83

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債
發行日期	2014年4月15日
面額	新台幣100,000元
發行及交易地點	不適用
發行價格	每張新台幣100,000元整
總額	新台幣400,000,000元
利率	0%
期限	3年期 到期日：2017年4月15日
保證機構	不適用
受託人	中國信託商業銀行股份有限公司信託部
承銷機構	中國信託綜合證券股份有限公司
簽證律師	陳祐良律師
簽證會計師	陳慧銘、謝明忠
償還方法	詳轉換辦法。
債券持有人之賣回權	詳轉換辦法。
限制條款	無
未償還金額	新台幣371,500,000元
已轉換普通股之金額	已轉換普通股計502,636股，金額為新台幣5,026,360元。
發行時轉換價格	新台幣60.0元
最新轉換價格	新台幣56.7元

單位：新台幣仟元；%

主要產品	2011		2012		2013		2014	
	銷值	%	銷值	%	銷值	%	銷值	%
3C電子類	767,700	66.21	1,370,297	70.90	1,331,346	62.95	2,013,689	65.63
汽車零件類	216,748	18.69	357,987	18.52	577,066	27.29	783,838	25.55
建築建材類	106,642	9.20	132,473	6.85	120,318	5.69	121,130	3.95
模具	68,423	5.90	71,957	3.72	86,161	4.07	149,673	4.88
合計	1,159,513	100.00	1,932,714	100.00	2,114,891	100.00	3,068,330	100.00



**LemTech**

Lemtech Holdings Co., Limited

# Q & A

